

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2009年4月23日 (23.04.2009)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2009/050786 A1

(51) 国際特許分類:

C09J 133/08 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)
C09J 4/02 (2006.01) H01L 21/52 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)

中村 1 1 3 5 電気化学工業株式会社 渋川工場
内 Gunma (JP). 高津 知道 (TAKATSU, Tomomichi)
[JP/JP]; 〒3778520 群馬県渋川市中村 1 1 3 5 電気
化学工業株式会社 渋川工場内 Gunma (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2007/070166

(74) 代理人: 園田 吉隆, 外 (SONODA, Yoshitaka et al.);
〒1630453 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号 新宿
三井ビル 5 3 階 園田・小林特許事務所 Tokyo (JP).

(22) 国際出願日:

2007年10月16日 (16.10.2007)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 電
気化学工業株式会社 (DENKI KAGAKU KOGYO
KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中
央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH,
BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(72) 発明者; および

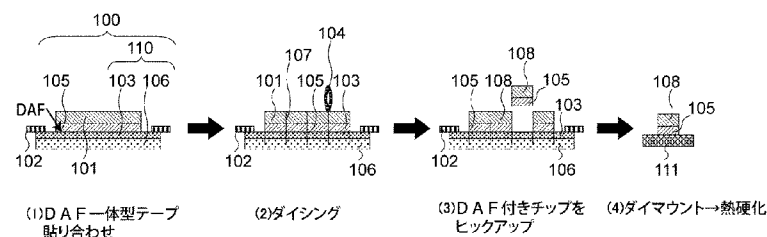
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 齊藤 岳史
(SAITO, Takeshi) [JP/JP]; 〒3778520 群馬県渋川市

[続葉有]

(54) Title: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE, PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE SHEET, MULTILAYERED
PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE SHEET, AND METHOD FOR MANUFACTURING ELECTRONIC COMPONENT

(54) 発明の名称: 粘着剤、粘着シート、多層粘着シート及び電子部品の製造方法

[図1]

AA
DAF使用工程

AA STEP OF USING DAF
(1) APPLICATION OF DAF INTEGRATED TAPE
(2) DICING
(3) PICK-UP OF CHIP WITH DAF
(4) DIE MOUNT → HEAT CURING

(57) Abstract: This invention provides a multilayered pressure-sensitive adhesive sheet (100) comprising a base film (106), a pressure-sensitive adhesive layer (103), formed by coating a pressure-sensitive adhesive having a specific composition onto the base film (106), and a die attach film (105) stacked on the pressure-sensitive adhesive layer (103). The multilayered pressure-sensitive adhesive sheet (100) using the pressure-sensitive adhesive having a specific composition is advantageous in that the die chip (108) holding property in dicing of a silicon wafer (101) is excellent, the multilayered pressure-sensitive adhesive sheet (100) is less likely to come off from a ring frame (102) in dicing the silicon wafer (101), and the separation of the die attach film (105) from the pressure-sensitive adhesive layer (103) is easy in pick-up work of the die chip (108).

(57) 要約: 多層粘着シート 100 は、基材フィルム 106 と、その基材フィルム 106 に特定の組成からなる粘着剤を塗布してなる粘着剤層 103 と、その粘着剤層 103 上に積層されてなるダイアタッチフィルム 105

[続葉有]

WO 2009/050786 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK,

TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

と、を備える。この特定の組成からなる粘着剤を用いる多層粘着シート１００は、シリコンウエハ１０１のダイシング時におけるダイチップ１０８の保持性に優れ、シリコンウエハ１０１のダイシング時にリングフレーム１０２から多層粘着シート１００が外れにくく、ダイチップ１０８のピックアップ作業時にダイアタッチフィルム１０５と粘着剤層１０３との剥離が容易である。